历史版本

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	吴良清	2019-12-3	发布初稿	

文档问题反馈: wlq@rock-chips.com

Rockchip Android 10.0 SDK支持芯片

芯片平台	是否支持	SDK版本
RK3326	支持	RKR1
PX30	支持	RKR1
RK3126C	支持	RKR3
RK3288	暂不支持	
RK3368	暂不支持	
RK3399	暂不支持	

Rockchip Android 10.0 SDK代码下载编译

代码下载

下载地址

repo init --repo-url=ssh://git@10.10.10.78:2222/repo-release/tools/repo.git -u ssh://git@10.10.10.78:2222/Android_Qt/manifests.git -m Android10.xml

为方便客户快速获取SDK源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的SDK初始压缩包。以 Rockchip_Android_Qt_SDK_Release.tar.gz.*为例,拷贝到该初始化包后,通过如下命令可检出源码:

```
mkdir Android_Qt
cat Rockchip_Android_Qt_SDK_Release.tar.gz* | tar -zx -C Android_Qt
cd Android_Qt
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c
```

代码编译

一键编译命令

./build.sh -UKAup

编译命令说明

芯片平台	Uboot编 译	kernel编译	Android编译
RK3326	cd uboot ./make.sh rk3326	cd kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config make ARCH=arm64 rk3326-863-lp3- v10-rkisp1.img -j24	source build/envsetup.sh lunch rk3326_qt- userdebug make -j24 ./mkimage.sh

芯片平台	Uboot编 译	kernel编译	Android编译
PX30	cd uboot ./make.sh px30	cd kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config make ARCH=arm64 px30-evb-ddr3- v10-avb.img -j24	source build/envsetup.sh lunch PX30_Android10- userdebug make -j24 ./mkimage.sh
RK3368	cd uboot ./make.sh rk3368	cd kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config make ARCH=arm64 rk3368-xikp- avb.img -j20	source build/envsetup.sh lunch rk3368_Android10- userdebug make -j24 ./mkimage.sh
RK3399	cd uboot ./make.sh rk3399	cd kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config 挖掘机 make ARCH=arm64 rk3399-sapphire- excavator-edp-avb.img -j24 RK3399 LPDDR4+RK809新开发板 make ARCH=arm64 rk3399-evb-ind- lpddr4-android-avb.img -j24	source build/envsetup.sh lunch rk3399_Android10- userdebug make -j24 ./mkimage.sh
RK3126C	cd uboot ./make.sh rk3126	cd kernel make ARCH=arm rockchip_defconfig android-10.config make ARCH=arm rk3126-bnd-d708- avb.img -j24	source build/envsetup.sh lunch rk3126c_qt- userdebug make -j24 ./mkimage.sh
RK3328	cd uboot ./make.sh rk3328	cd kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config ## 联通样机BOX编译命令: make ARCH=arm64 rk3328-box- liantong-avb.img -j24 ## EVB 板编译命令: make ARCH=arm64 rk3328-evb- android-avb.img -j24	source build/envsetup.sh ## 联通样机BOX编译 命令: lunch rk3328_box- userdebug ## EVB 板 ATV编译命 令: lunch rk3328_atv- userdebug make -j24 ./mkimage.sh

芯片平台	Uboot编 译	kernel编译	Android编译
RK3229	cd uboot ./make.sh rk322x	cd kernel make ARCH=arm rockchip_defconfig android-10.config ## EVB 板编译命令: make ARCH=arm rk3229-evb-android- avb.img -j24	source build/envsetup.sh ## EVB 板 BOX编译命 令: lunch rk3328_box- userdebug make -j24 ./mkimage.sh

其他编译说明

Android10.0不能直接烧写kernel.img和resource.img

Android10.0的kernel.img和resource.img包含在boot.img中,更新编译kernel后需要在android根目录下执行./mkimage.sh重新打包boot.img。打包后烧写rockdev下面的boot.img,可以使用如下方法单独编译kernel。

单独编译kernel生成boot.img

编译的原理:在kernel目录下将编译生成的 kernel.img 和 resource.img 替换到旧的 boot.img 中,所以编译的时候需要用 BOOT_IMG=xxx 参数指定boot.img的路径,命令如下:以 RK3326 863 样机为例,编译时替换对应的boot.img及dts:

```
cd kernel
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/rk3326_qt/boot.img rk3326-863-lp3-v10-
rkisp1.img -j24
```

编译后可以直接烧写kernel目录下的boot.img(**注意: 32bit的平台是zboot.img, 如3126c**) 到机器的boot位置,烧写时**请先加载分区表(parameter.txt)**,以免烧写位置错误。

支持从P升级到Q版本:

以RK3326为例

• 编译命令:

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3326_pie-userdebug
make -j24
./mkimage.sh
```

• 请把odm.img烧写到oem的位置,附烧写工具配置:

固件烧写

固件烧写工具

Windows烧写工具:

RKTools/windows/AndroidTool/AndroidTool_Release_v2.71



Linux工具:

```
RKTools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool_v1.43
```

在下文工具说明章节有详细说明

固件说明

完整编译后会生成如下文件: (以RK3326为例,这里lunch的是rk3326_qgo-userdebug)

```
rockdev/Image-rk3326_qgo/
├─ boot.img
├─ config.cfg
— dtbo.img
├─ kernel.img
├─ MiniLoaderAll.bin
├─ misc.img
— odm.img
parameter.txt
pcba_small_misc.img
pcba_whole_misc.img
— recovery.img
- resource.img
— super.img
— system.img
— trust.img
— uboot.img
— update.img
— vbmeta.img
 vendor.img
```

工具烧写如下文件即可:

也可以直接烧写 update.img

其他说明

Q的新设备支持动态分区,已经移除了system/vendor/odm分区,请烧写super.img,单独烧写system/vendor/odm可以用fastbootd,使用命令:

```
adb reboot fastboot
fastboot flash vendor vendor.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash odm odm.img
```

烧写gsi:

进入fastboot后,只需要烧写gsi中的system.img,烧写后会进入recovery进行恢复出厂设置。

Android 10.0特性

编译系统

SDK版本号变更

首先,在PDK代码中取消了 PLATFORM_VERSION 这个宏,并且在后续的AOSP中,此宏会变更为10.0,导致编译系统判断变量出错,因此统一修改为 PLATFORM_SDK_VERSION ,如果你发现某个功能不能用或崩溃了,到源码目录去查看有没有引用到这个宏。

两者的对应关系如下:

PLATFORM_VERSION	PLATFORM_SDK_VERSION
7.0	24
7.1	25
8.0	26
8.1	27
9.0	28
10.0	29

mk文件重复加载

这个问题早期版本就一直存在,只是影响不大,会少许影响编译速度。新版本中引入了 readonly 机制,指定为只读的变量不可以再赋值,所以在重复加载时会编译报错。对此,推荐以下结构避免被重复加载:

```
# First lunching is Q, api_level is 29
PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL := 29
PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE := $(LOCAL_PATH)/fstab.in
PRODUCT_DTBO_TEMPLATE := $(LOCAL_PATH)/dt-overlay.in
PRODUCT_BOOT_DEVICE := ff390000.dwmmc,ff3b0000.nandc
include device/rockchip/common/build/rockchip/DynamicPartitions.mk
include device/rockchip/common/BoardConfig.mk
include device/rockchip/rk3326/rk3326_qt/BoardConfig.mk
$(call inherit-product, device/rockchip/rk3326/device-common.mk)
$(call inherit-product, device/rockchip/common/device.mk)
$(call inherit-product, frameworks/native/build/tablet-10in-xhdpi-2048-dalvik-
heap.mk)
PRODUCT CHARACTERISTICS := tablet
PRODUCT_NAME := rk3326_qt
PRODUCT_DEVICE := rk3326_qt
PRODUCT_BRAND := rockchip
PRODUCT_MODEL := rk3326_qt
PRODUCT_MANUFACTURER := rockchip
PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG := tvdpi
## add Rockchip properties
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.sf.lcd_density=160
```

相比旧版本,主要是调了下顺序,删了点include {.is-info}

mk文件copy机制

在mk中,PRODUCT_COPY 这个宏只能够执行一次,因此,拷贝的目标文件为同名时,只有前面被声明的命令会执行。常见问题,bringup后 adb 无法使用。

fstab动态生成器

由于Android中存在大量的可配置项,SDK又将用于行业应用,配置的冲突在所难免。增加这个脚本以减少修改配置时,需要额外修改的内容。使用方法:

新增模板文件,并在mk中配置好即可:

PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE := \$(LOCAL_PATH)/fstab.in

```
${_block_prefix}system /system ext4 ro,barrier=1
${_flags_vbmeta},first_stage_mount
${_block_prefix}vendor /vendor ext4 ro,barrier=1 ${_flags},first_stage_mount
${_block_prefix}odm /odm ext4 ro,barrier=1 ${_flags},first_stage_mount
/dev/block/by-name/metadata /metadata ext4 nodev,noatime,nosuid,discard,sync
wait,formattable,first_stage_mount
/dev/block/by-name/misc
                          /misc
                                                              defaults
                                                    emmc
defaults
/dev/block/by-name/cache
                                 /cache
                                                      ext4
noatime, nodiratime, nosuid, nodev, noauto_da_alloc, discard
wait, check
/devices/platform/*usb* auto vfat defaults
                                               voldmanaged=usb:auto
/dev/block/zram0
                                                none
                                                                    swap
defaults
                                                      zramsize=50%
# For sdmmc
/devices/platform/ff370000.dwmmc/mmc_host*
                                                 auto auto defaults
voldmanaged=sdcard1:auto,encryptable=userdata
# Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime, nosuid, nodev, discard, reserve_root=32768, resgid=1065, fsync_mode=nobarrier
latemount, wait, check, fileencryption=software, quota, formattable, reservedsize=128M
,checkpoint=fs
```

dtbo.img动态生成器

增加这个功能理由同上,可以兼容其它功能,如 SD Boot,该功能需要修改 boot_devices 为 sdmmc 的 地址,使用方法:

新增模板文件,并在mk中配置好即可, **注意,使用dtbo时一定要确保dts中存在alias,否则无法成功 overlay**:

```
PRODUCT_DTBO_TEMPLATE := $(LOCAL_PATH)/dt-overlay.in
PRODUCT_BOOT_DEVICE := ff390000.dwmmc,ff3b0000.nandc //修改为sdmmc时可以从sd卡启动
```

```
/dts-v1/;
/plugin/;
&chosen {
    bootargs_ext = "androidboot.boot_devices=${_boot_device}";
};
&firmware_android {
    vbmeta {
        status = "disabled";
   };
    fstab {
        status = "disabled";
    }:
};
&reboot_mode {
    mode-bootloader = <0x5242C309>;
    mode-charge = <0x5242C30B>;
    mode-fastboot = <0x5242C303>;
    mode-loader = <0x5242C301>;
```

```
mode-normal = <0x5242C300>;
mode-recovery = <0x5242C303>;
};
```

sepolicy的ioctl控制机制

libsync库访问内核节点变更由 /dev/sw_sync 变更为 /sys/kerne1/debug/sync/sw_sync , 此项修改会引出大量的sepolicy问题,对此,需要说明sepolicy的ioctl控制机制。

• 在rules中添加ioctl后,还需要声明具体的iocmd,必须结合源代码添加,例如:

```
allow hal_graphics_composer_default debugfs_sw_sync:file { ioctl };
allowxperm hal_graphics_composer_default debugfs_sw_sync:file ioctl {
SYNC_IOC_MERGE SW_SYNC_IOC_INC SW_SYNC_IOC_CREATE_FENCE };
```

新Feature或变更

屏幕旋转

Android 10.0取消了ConfigStoreHAL,问题多旦内存占用高,更换回 prop 的方式,对此,SDK已经相应的做了修改,使用方法:

mk文件中指定旋转方向:

```
# set screen rotation: 0/90/180/270
SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION := 0
```

manifest升级

在引入 treble 技术后(于 Android Oreo 引入),所有的hal都需要从manifest中声明,并且在新的 Android版本中都需要更新 target-level ,所以如果你的manifest.xml文件没有修改,会编译不过。 参考:

```
device/rockchip/rk3326/manifest.xml
```

boot header 2引入

在原先的 header 1 的基础上,新增了 dtb 的支持,需要在编译时将 dtb (复数) 打包到 boot.img中,对此,新的product需要指定dtb的目录:

```
BOARD_INCLUDE_DTB_IN_BOOTIMG := true
BOARD_PREBUILT_DTBIMAGE_DIR := kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip
```

对于升级到Q的设备,则要置空:

```
# No need to place dtb into boot.img for the device upgrading to Q.
BOARD_INCLUDE_DTB_IN_BOOTIMG :=
BOARD_PREBUILT_DTBIMAGE_DIR :=
```

early mount**引入**

最新的Android 10中,ramdisk再次回归boot.img,所以分区的mount fstab配置又需要到fstab文件中配置了,但和8.1不同的是,ramdisk中的fstab还可以支持earlymount,而8.1的earlymount只能在dts文件中配置,**而10.0中需要保证节点为空或disabled状态**。因此,需要同时拷贝fstab文件到vendor/etc及ramdisk下,这里推荐使用fstab动态生成器,会自动生成支持earlymount的fstab文件并拷贝到对应的目录,如果不使用,则通过以下的宏拷贝:

```
ifndef PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE
$(warning Please add fstab.in with PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE in your product.mk)
# To use fstab auto generator, define fstab.in in your product.mk,
# Then include the device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildFstab.mk in your
AndroidBoard.mk

PRODUCT_COPY_FILES += \

$(TARGET_DEVICE_DIR)/fstab.rk30board:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/fstab.rk30board)
$(TARGET_DEVICE_DIR)/fstab.rk30board:$(TARGET_COPY_OUT_RAMDISK)/fstab.rk30board)
endif # Use PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE
```

新的kernel config要求

在新的Android 10.0以及后续需要通过的GMS认证中,新增了大量的config,所以在新的编译系统中, 建议使用新的内核编译命令: make ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-10.config

动态分区

该功能中的变量都是只读,因此将其分离到单独的文件中,以模块化的方式处理,使用方法: mk文件中包含此文件即可:

include device/rockchip/common/build/rockchip/DynamicPartitions.mk

如果觉得这几个分区 (system/vendor/odm) 预留的太小, push大文件时, 可以修改该文件:

```
BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_RESERVED_SIZE := 52428800
BOARD_VENDORIMAGE_PARTITION_RESERVED_SIZE := 52428800
BOARD_ODMIMAGE_PARTITION_RESERVED_SIZE := 52428800
```

fastbootd

该功能需要使能动态分区后才能用,配合修改的地方有两处,**注意这里不要修改vendorld,目前使用 的是google的bootloader驱动,Windows平台也能正常识别和烧写固件**:

• init.recovery.rk30board.rc文件

```
on early-fs
setprop sys.usb.controller "ff300000.usb" //这里要修改为对应平台的controller
setprop sys.usb.configfs 1

on fs && property:sys.usb.configfs=1
write /config/usb_gadget/g1/bcdDevice 0x0310
write /config/usb_gadget/g1/bcdUSB 0x0200
write /config/usb_gadget/g1/os_desc/b_vendor_code 0x1
write /config/usb_gadget/g1/os_desc/qw_sign "MSFT100"
write /config/usb_gadget/g1/configs/b.1/MaxPower 500
symlink /config/usb_gadget/g1/configs/b.1 /config/usb_gadget/g1/os_desc/b.1
```

• reboot mode支持fastboot, 前面的 dtbo动态生成器 中便是支持reboot mode的模板。

文件加密

该功能并不是新功能,只是rockchip的sdk中引入的新功能,也是android 10的强制要求功能。 使能文件加密,修改fstab文件,在 fstab动态生成器 中便是支持文件加密的模板:

```
/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nodiratime,nosuid,nodev,discard,inline_xattr
wait,check,notrim,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M
```

除了fstab文件的修改,还支持分阶段挂载分区,以提高开机速度,**注意,非文件加密不能使用分阶段 挂载,磁盘加密请务必检查一下,否则将无法启动**:

分阶段挂载示例:

```
# do mount_all early can imporve boot time when FBE
# is enabled
on fs
    mount_all /vendor/etc/fstab.${ro.hardware} --early
on late-fs
    # Start services for bootanim
    start servicemanager
    start hwcomposer-2-1
    start gralloc-2-0
    start surfaceflinger
    start bootanim

# Mount RW partitions which need run fsck
    mount_all /vendor/etc/fstab.${ro.hardware} --late
```

不分阶段加载示例:

```
on fs
   mount_all /vendor/etc/fstab.${ro.hardware}
```

用户数据检查点 (UDC)

该功能需要data分区为f2fs,修改fstab文件以支持该功能,在 fstab动态生成器 中便是支持UDC的模板:

```
/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065,fsync_mode=nobarrier
latemount,wait,check,fileencryption=software,quota,formattable,reservedsize=128M
,checkpoint=fs
```

avb中vbmeta增加公钥元数据

更高级的avb锁,需要证书才能解锁,详情请参考uboot的security部分文档,SDK中指定以下宏开启编译元数据功能:

```
BOARD_AVB_ENABLE := true
BOARD_AVB_METADATA_BIN_PATH := \
    external/avb/test/data/atx_metadata.bin
```

Android常用配置

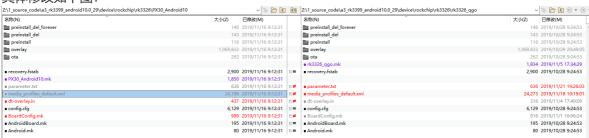
新建产品lunch

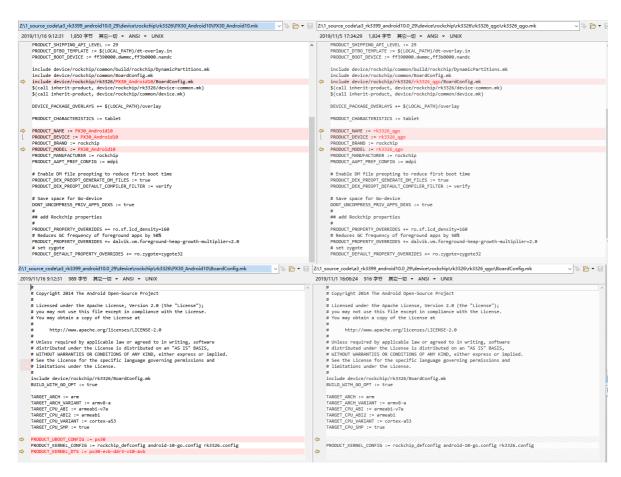
以RK3326平台新建PX30_Android10产品为例,分以下步骤:

1,修改device/rockchip/rk3326/AndroidProducts.mk增加PX30_Android10的lunch

```
diff --git a/AndroidProducts.mk
index 44d8475..e2f7c02 100755
--- a/AndroidProducts.mk
+++ b/AndroidProducts.mk
@@ -15,11 +15,14 @@
 PRODUCT_MAKEFILES := \
        $(LOCAL_DIR)/PX30_Android10/PX30_Android10.mk \
        $(LOCAL_DIR)/rk3326_pie/rk3326_pie.mk \
        $(LOCAL_DIR)/rk3326_qt/rk3326_qt.mk \
        $(LOCAL_DIR)/rk3326_qgo/rk3326_qgo.mk
COMMON_LUNCH_CHOICES := \
       PX30_Android10-userdebug \
       PX30_Android10-user \
    rk3326_qt-userdebug \
     rk3326_qt-user \
     rk3326_qgo-userdebug \
```

2,在device/rockchip/rk3326目录下新建PX30_Android10目录 参考device/rockchip/下已有的rk3326_qgo产品目录新建,可以先直接拷贝rk3326_qgo为 PX30_Android10,然后将PX30_Android10目录下的所有 rk3326_qgo 字符改为 px30_Android10 具体修改如下图:





GMS认证

在Android 10.0中,如果需要通过GMS认证,需要将GMS包下载放到vendor目录下。

- 1. 通过RK的manifest (推荐, 一键部署, 包含RK修改, 减少GTS各种问题)
- 获取GMS包 此时需要先联系FAE获取GMS包权限(**需要MADA**),开通后,使用以下命令切换并重新同步工程:

```
.repo/repo/repo init -m Android10_Express.xml
.repo/repo/repo sync -c
```

• 打开配置GMS

```
device/rockchip/rkxxxx/BoardConfig.mk中配置:
# Google Service and frp overlay

BUILD_WITH_GOOGLE_MARKET := true
BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := true
BUILD_WITH_GOOGLE_GMS_EXPRESS := false (此项做Express的客户设置为true, funding的客户请参考GMS的文档修改)
```

2. 自行从实验室或其他渠道获取GMS包 (**不推荐**) 获取后,放置于vendor目录,此时vendor下的结构如下:

```
vendor$ ls
partner_gms partner_modules (原有目录: rockchip widevine )
```

• 打开配置GMS

Kernel dts说明

新建产品dts

产品新建dts可以根据下表的配置选择对应的dts作为参考。

Soc	PMIC	DDR	类型	机型	DTS
RK3326	RK817	DDR3	开发 板	evb	rk3326-evb-lp3-v10-avb
PX30	RK809	DDR3	开发 板	evb	px30-evb-ddr3-v10-avb
RK3326	RK817	DDR3	平板	芯图863	rk3326-863-lp3-v10-rkisp1
RK3399	RK808	LPDDR3	开发 板	挖掘机	rk3399-sapphire-excavator- edp-avb
RK3399	RK809	LPDDR4	开发 板	IND新开发板	rk3399-evb-ind-lpddr4- android-avb
RK3126C	RK816	DDR3	平板	百能达D708	rk3126-bnd-d708-avb
RK3126C	RK816	DDR3	平板	百能达M88 EMMC	rk3126-bnd-m88-emmc
RK3368	RK818	LPDDR3	平板	希科普	rk3368-xikp-avb

文档说明

Android文档

RKDocs\android

Wi-Fi文档

RKDocs/android/wifi/

 ${\color{blue} \longleftarrow } \textbf{Rockchip_Introduction_Android10.0_WIFI_Configuration_CN\&EN.pdf}$

□─ Rockchip_Introduction_REALTEK_WIFI_Driver_Porting_CN&EN.pdf

3G/4G模块说明文档

Kernel文档

RKDocs\common

DDR相关文档

RKDocs/common/DDR/

— Rockchip-Developer-Guide-DDR-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-DDR-EN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-DDR-Problem-Solution-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-DDR-Problem-Solution-EN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-DDR-Verification-Process-CN.pdf

Audio模块文档

CRU模块文档

RKDocs/common/CRU/

— Rockchip_Developer_Guide_Linux3.10_Clock_CN.pdf

— Rockchip_RK3399_Developer_Guide_Linux4.4_Clock_CN.pdf

GMAC模块文档

PCie模块文档

RKDocs/common/PCie/

□ Rockchip-Developer-Guide-linux4.4-PCIe.pdf

I2C模块文档

RKDocs/common/I2C/

— Rockchip_Developer_Guide_I2C_CN.pdf

PIN-Ctrl GPIO模块文档

RKDocs/common/PIN-Ctrl/

□ Rockchip-Developer-Guide-Linux-Pin-Ctrl-CN.pdf

SPI模块文档

RKDocs/common/SPI/

□ Rockchip-Developer-Guide-linux4.4-SPI.pdf

Sensor模块文档

RKDocs/common/Sensors/

— Rockchip_Developer_Guide_Sensors_CN.pdf

IO-Domain模块文档

RKDocs/common/IO-Domain/

Lockchip_Developer_Guide_Linux_IO_DOMAIN_CN.pdf

Leds模块文档

RKDocs/common/Leds/

— Rockchip_Introduction_Leds_GPIO_Configuration_for_Linux4.4_CN.pdf

Thermal温控模块文档

RKDocs/common/Thermal/

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-Thermal-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-Thermal-EN.pdf

PMIC电源管理模块文档

RKDocs/common/PMIC/

├─ Archive.zip

— Rockchip_Developer_Guide_Power_Discrete_DCDC_EN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-Power-Discrete-DCDC-Linux4.4.pdf

- Rockchip-Developer-Guide-RK805.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_RK817_RK809_Fuel_Gauge_CN.pdf

— Rockchip_RK805_Developer_Guide_CN.pdf

Rockchip_RK818_RK816_Introduction_Fuel_Gauge_Log_CN.pdf

MCU模块文档

```
RKDocs/common/MCU/

— Rockchip_Developer_Guide_MCU_EN.pdf
```

功耗与休眠模块文档

UART模块文档

DVFS CPU/GPU/DDR变频相关文档

```
RKDocs/common/DVFS/

— Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_CN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_EN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_Devfreq_CN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_Linux4.4_CPUFreq_CN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_Linux4.4_Devfreq_CN.pdf
```

EMMC/SDMMC/SDIO模块文档

RKDocs/common/MMC

☐ Rockchip-Developer-Guide-linux4.4-SDMMC-SDIO-eMMC.pdf

PWM模块文档

USB模块文档

```
RKDocs/common/usb/

— putty20190213_162833_1.log

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-RK3399-USB-DTS-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-USB-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-USB-FFS-Test-Demo-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-USB-Gadget-UAC-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-USB-Initialization-Log-Analysis-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-USB-Performance-Analysis-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-USB-PHY-CN.pdf

— Rockchip-Developer-Guide-USB-SQ-Test-CN.pdf
```

HDMI-IN功能文档

RKDocs/common/hdmi-in/

L— Rockchip_Developer_Guide_HDMI_IN_CN.pdf

安全模块文档

RKDocs/common/security/

- -- Efuse process explain .pdf
- RK3399_Efuse_Operation_Instructions_V1.00_20190214_EN.pdf
- Rockchip_Developer_Guide_Secure_Boot_V1.1_20190603_CN.pdf
- Rockchip_Developer_Guide_TEE_Secure_SDK_CN.pdf
- Rockchip_RK3399_Introduction_Efuse_Operation_EN.pdf
- Prockchip-Secure-Boot2.0.pdf
- Rockchip-Secure-Boot-Application-Note-V1.9.pdf
- └─ Rockchip Vendor Storage Application Note.pdf

uboot介绍文档

RKDocs\common\u-boot\Rockchip-Developer-Guide-UBoot-nextdev-CN.pdf

Trust介绍文档

RKDocs/common/TRUST/

- Rockchip_Developer_Guide_Trust_CN.pdf
- Rockchip_Developer_Guide_Trust_EN.pdf

Camera文档

RKDocs\common\camera\HAL3\

工具文档

RKDocs\common\RKTools manuals

PCBA开发使用文档

 $RKDocs \\ and \\ roid \\ Rockchip_Developer_Guide_PCBA_Test_Tool_CN\&EN.pdf$

显示屏驱动调试指南

RKDocs\common\display\Rockchip_Developer_Guide_DRM_Panel_Porting_CN.pdf

HDMI调试指南

RKDocs\common\display\Rockchip_Developer_Guide_HDMI_Based_on_DRM_Framework_CN.pd f

图像显示DRM Hardware Composer (HWC) 问题分析排查

RKDocs\common\display\Rockchip FAQ DRM Hardware Composer V1.00-20181213.pdf

DRM显示开发指南

RKDocs\common\display\Rockchip DRM Display Driver Development Guide V1.0.pdf

RGA相关问题分析排查

RKDocs\common\display\Rockchip_RGA_FAQ.pdf

工具使用

StressTest

设备上使用Stresstest 工具,对待测设备的各项功能进行压力测试,确保各项整个系统运行的稳定性。 SDK通过打开计算器应用,输入"83991906="暗码,可启动StressTest应用,进行各功能压力测试。 Stresstest 测试工具测试的内容主要包括:

模块相关

- Camera 压力测试:包括Camera 打开关闭, Camera 拍照以及Camera 切换。
- Bluetooth 压力测试:包括Bluetooth 打开关闭。
- Wifi 压力测试:包括Wifi 打开关闭, (ping 测试以及iperf 测试待加入)。

非模块相关

- 飞行模式开关测试
- 休眠唤醒拷机测试
- 视频拷机测试
- 重启拷机测试
- 恢复出厂设置拷机测试
- Arm 变频测试
- Gpu 变频测试
- DDR 变频测试

PCBA测试工具

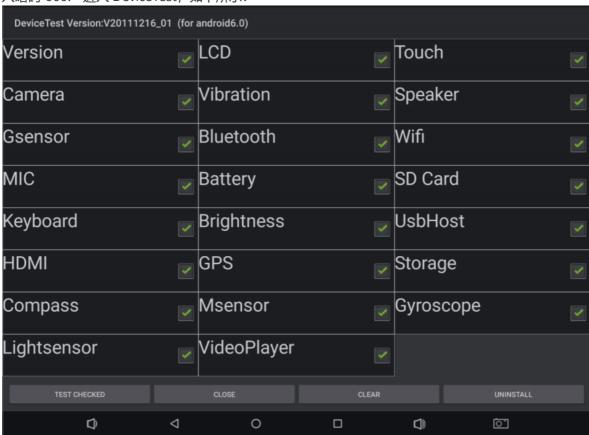
PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速地甄别产品功能的好坏,提高生产效率。目前包括屏幕(LCD)、无线(Wi-Fi)、蓝牙(bluetooth)、DDR/EMMC 存储、SD 卡(sdcard)、USB HOST、按键(KEY),喇叭耳机(Codec)测试项目。

这些测试项目包括自动测试项和手动测试项,无线网络、DDR/EMMC、以太网为自动测试项,按键、

SD卡、USB HOST、Codec、为手动测试项目。 具体PCBA功能配置及使用说明,请参考:

DeviceTest

DeviceTest 用于工厂整机测试,主要测试装成整机以后外围器件是否正常。SDK 通过打开计算器,输入暗码"000.="进入 DeviceTest,如下所示:



在产线可以根据这个界面进行对应外设的测试,测试时点击"TEST CHECKED"对所测项目 逐项进行测试,测试如果成功点击 pass,失败点击 failed,最终结果会显示在界面上,如下图所示,红色为 failed 项,其余为通过项,工厂可根据测试结果进行相应的维修。另外,如果客户需要对该工具进行定制,请联系 FAE 窗口申请对应的源码。

USB驱动

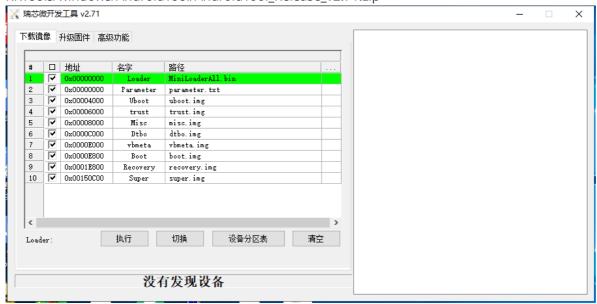
Rockchip USB驱动安装包,包括ADB、固件烧写驱动

RKTools\windows\DriverAssitant_v4.5.zip

开发烧写工具

Windows版本

RKTools/windows/AndroidTool/AndroidTool_Release_v2.71.zip



Linux版本

RKTools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool_v1.43.zip

```
Linux_Upgrade_Tool_v1.43$ sudo ./upgrade_tool -h
Program Data in /home/wlq/.config/upgrade_tool
-----Tool Usage -----
не]р:
                Н
Ouit:
                Q
Version:
Clear Screen:
               CS
-----Upgrade Command ------
ChooseDevice:
                     CD
ListDevice:
                         ΙD
SwitchDevice:
                     SD
UpgradeFirmware:
                    UF <Firmware> [-noreset]
UpgradeLoader:
                    UL <Loader> [-noreset]
DownloadImage:
                    DI \langle -p|-b|-k|-s|-r|-m|-u|-t|-re image>
DownloadBoot:
                    DB <Loader>
EraseFlash:
                     EF <Loader|firmware> [DirectLBA]
PartitionList:
                     PL
WriteSN:
                     SN <serial number>
                 RSN
-----Professional Command -----
TestDevice:
                     TD
                     RD [subcode]
ResetDevice:
ResetPipe:
                     RP [pipe]
ReadCapability:
                    RCB
ReadFlashID:
                     RID
ReadFlashInfo:
                     RFI
ReadChipInfo:
                     RCI
ReadSector:
                     RS <BeginSec> <SectorLen> [-decode] [File]
WriteSector:
                     WS <BeginSec> <File>
                     RL <BeginSec> <SectorLen> [File]
ReadLBA:
WriteLBA:
                     WL <BeginSec> <File>
                     EL <BeginSec> <EraseCount>
EraseLBA:
EraseBlock:
                     EB <CS> <BeginBlock> <BlokcLen> [--Force]
```

SD升级启动制作工具

用于制作SD卡升级、SD卡启动、SD卡PCBA测试

RKTools\windows\SDDiskTool_v1.59.zip

写号工具

RKTools\windows\RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.0.3.rar 解压RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.0.3.rar后安装 以管理员权限打开软件

Rk	(DevInfoWriteTo	pol V1.0.3	×
设置	日志文件 关于	F	
	SN:		
	WIFI:		
	LAN:		
	BT:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	IMEI:	读取	
	自定义1	写入	
	自定义2:		
	LOADER:	\\10.10.10.205\wlq\1_source_code\a3_rk3399_android10.0_29\rockc	
		没有发现设备	

工具说明请参考:

RKDocs\common\RKTools manuals\RKDevInfoWriteTool_User_Guide_v1.0.3.pdf

DDR焊接测试工具

RKTools\windows\Rockchip_Platform_DDR_Test_Tool_V1.38_Release_Annoucement_CN.7z RKTools\windows\Rockchip_Platform_DDR_Test_Tool_V1.38_Release_Annoucement_EN.7z

efuse烧写工具

用于efuse的烧写,适用于RK3288/RK3368/RK3399平台

RKTools\windows\efuse_v1.37.rar

efuse/otp签名工具

用于固件的efuse/otp签名

RKTools\windows\SecureBootTool_v1.94.zip

工厂生产固件烧写工具

用于工厂批量烧写固件

RKTools\windows\FactoryTool_1.66.zip

固件修改工具

用于修改update.img固件

RKTools\windows\FWFactoryTool_V5.52.rar

userdata分区数据预置工具

用于制作userdata分区预置数据包的工具

RKTools\windows\OemTool_v1.3.rar

系统调试

ADB工具

概述

ADB(Android Debug Bridge)是 Android SDK里的一个工具,用这个工具可以操作管理 Android 模拟器或真实的 Android 设备。主要功能有:

- 运行设备的 shell (命令行)
- 管理模拟器或设备的端口映射
- 计算机和设备之间上传/下载文件

- 将本地 apk软件安装至模拟器或 Android 设备
 ADB 是一个"客户端 服务器端"程序,其中客户端主要是指PC,服务器端是Android 设备的实体机器或者虚拟机。根据PC连接Android设备的方式不同,ADB可以分为两类:
- 网络 ADB: 主机通过有线/无线网络 (同一局域网) 连接到STB设备
- USB ADB: 主机通过 USB 线连接到STB设备

USB adb使用说明

USB adb 使用有以下限制:

- 只支持 USB OTG 口
- 不支持多个客户端同时使用(如 cmd 窗口, eclipse等)
- 只支持主机连接一个设备,不支持连接多个设备
 - 连接步骤如下:
 - 1、Android设备已经运行 Android 系统,设置->开发者选项->已连接到计算机 打开,usb调试开关打开。
 - 2、PC主机只通过 USB 线连接到机器 USB otg 口,然后电脑通过如下命令与Android设备相连。

adb shell

3、测试是否连接成功,运行"adb devices"命令,如果显示机器的序列号,表示连接成功。

网络adb使用要求

adb早期版本只能通过USB来对设备调试,从adb v1.0.25开始,增加了对通过tcp/ip调试Android设备的功能。

如果你需要使用网络adb来调试设备,必须要满足如下条件:

- 1、设备上面首先要有网口,或者通过WiFi连接网络。
- 2、设备和研发机 (PC机) 已经接入局域网,并且设备设有局域网的IP地址。
- 3、要确保研发机和设备能够相互ping得通。
- 4、研发机已经安装了adb。
- 5、确保Android设备中adbd进程(adb的后台进程)已经运行。adbd进程将会监听端口5555来进行adb连接调试。

SDK网络adb端口配置

SDK默认未开启网络adb,需要手动在开发者选项中打开。

Setting-System-Advanced-Developer options-Open net adb

网络adb使用

本节假设设备的ip为192.168.1.5,下文将会用这个ip建立adb连接,并调试设备。

- 1、首先Android设备需要先启动,如果可以的话,可以确认adbd是否启动(ps命令查看)。
- 2、在PC机的cmd中,输入:

adb connect 192.168.1.5:5555

如果连接成功会进行相关的提示,如果失败的话,可以先kill-server命令,然后重试连接。

adb kill-server

- 3、如果连接已经建立,在研发机中,可以输入adb相关的命令进行调试了。比如adb shell,将会通过tcp/ip连接设备上面。和USB调试是一样的。
- 4、调试完成之后,在研发机上面输入如下的命令断开连接:

adb disconnect 192.168.1.5:5555

手动修改网络adb端口号

若SDK未加入adb端口号配置,或是想修改adb端口号,可通过如下方式修改:

- 1、首先还是正常地通过USB连接目标机,在windows cmd下执行adb shell进入。
- 2、设置adb监听端口:

#setprop service.adb.tcp.port 5555

- 3、通过ps命令查找adbd的pid
- 4、重启adbd

#kill -9, 这个pid就是上一步找到那个pid 杀死adbd之后, android的init进程后自动重启adbd。adbd重启后,发现设置了 service.adb.tcp.port,就会自动改为监听网络请求。

ADB常用命令详解

(1) 查看设备情况

查看连接到计算机的 Android 设备或者模拟器:

adb devices

返回的结果为连接至开发机的 Android 设备的序列号或是IP和端口号 (Port)、状态。

(2) 安装apk

将指定的 apk 文件安装到设备上:

adb install <apk文件路径>

示例如下:

adb install "F:\WishTV\WishTV.apk"

重新安装应用:

adb install -r "F:\WishTV\WishTV.apk"

(3) 卸载apk

完全卸载:

adb uninstall <package>

示例如下:

adb uninstall com.wishtv

(4) 使用 rm移除 apk 文件:

adb shell rm <filepath>

示例如下:

adb shell rm "system/app/WishTV.apk"

示例说明: 移除"system/app"目录下的"WishTV.apk"文件。

(5) 进入设备和模拟器的shell 进入设备或模拟器的 shell 环境:

adb shell

(6) 从电脑上传文件到设备

用 push 命令可以把本机电脑上的任意文件或者文件夹上传到设备。本地路径一般指本机电脑;远程路径一般指 adb 连接的单板设备。

adb push <本地路径> <远程路径>

示例如下:

adb push "F:\WishTV\WishTV.apk" "system/app"

示例说明:将本地"WishTV.apk"文件上传到 Android 系统的"system/app"目录下。

(7) 从设备下载文件到电脑

pull 命令可以把设备上的文件或者文件夹下载到本机电脑中。

adb pull <远程路径> <本地路径>

示例如下:

adb pull system/app/Contacts.apk F:\

示例说明:将 Android 系统"system/app"目录下的文件或文件夹下载到本地"F:\"目录下。

(8) 查看 bug报告

需要查看系统生成的所有错误消息报告,可以运行 adb bugreport指令来实现,该指令会将 Android 系统的dumpsys、dumpstate 与 logcat 信息都显示出来。

(9) 查看设备的系统信息

在 adb shell下查看设备系统信息的具体命令。

adb shell getprop

Logcat工具

Android 日志系统提供了记录和查看系统调试信息的功能。日志都是从各种软件和一些系统的缓冲区中记录下来的,缓冲区可以通过 Logcat 来查看和使用。Logcat 是调试程序用的最多的功能。该功能主要是通过打印日志来显示程序的运行情况。由于要打印的日志量非常大,需要对其进行过滤等操作。

Logcat命令使用

用 logcat 命令来查看系统日志缓冲区的内容: 基本格式:

```
[adb] logcat [<option>] [<filter-spec>]
```

示例如下:

```
adb shell
logcat
```

常用的日志过滤方式

控制日志输出的几种方式:

• 控制日志输出优先级示例如下:

```
adb shell
logcat *:W
```

示例说明:显示优先级为 warning 或更高的日志信息。

• 控制日志标签和输出优先级示例如下:

```
adb shell
logcat ActivityManager:I MyApp:D *:S
```

示例说明:支持所有的日志信息,除了那些标签为"ActivityManager"和优先级为"Info"以上的、标签为"MyApp"和优先级为"Debug"以上的。

• 只输出特定标签的日志 示例如下:

```
adb shell
logcat WishTV:* *:S
```

或者

```
adb shell
logcat -s WishTV
```

示例说明:只输出标签为 WishTV的日志。

只輸出指定优先级和标签的日志 示例如下:

```
adb shell
logcat wishTV:I *:S
```

示例说明:只输出优先级为 I,标签为 WishTV的日志。

Procrank工具

Procrank 是 Android 自带一款调试工具,运行在设备侧的 shell 环境下,用来输出进程的内存快照,便于有效的观察进程的内存占用情况。

包括如下内存信息:

- VSS: Virtual Set Size 虚拟耗用内存大小(包含共享库占用的内存)
- RSS: Resident Set Size 实际使用物理内存大小(包含共享库占用的内存)
- PSS: Proportional Set Size实际使用的物理内存大小(比例分配共享库占用的内存)
- USS: Unique Set Size 进程独自占用的物理内存大小(不包含共享库占用的内存) 注意:
- USS 大小代表只属于本进程正在使用的内存大小, 进程被杀死后会被完整回收;
- VSS/RSS 包含了共享库使用的内存,对查看单一进程内存状态没有参考价值;
- PSS 是按照比例将共享内存分割后,某单一进程对共享内存区的占用情况。

使用procrank

执行procrank前需要先让终端获取到root权限

su

命令格式:

```
procrank [ -w ] [ -v | -r | -p | -u | -h ]
```

常用指令说明:

- -v: 按照 VSS 排序
- -r: 按照 RSS 排序
- -p: 按照 PSS 排序
- -u: 按照 USS 排序
- -R: 转换为递增[递减]方式排序
- -w: 只显示 working set的统计计数
- -W: 重置 working set 的统计计数
- -h: 帮助

示例:

输出内存快照:

procrank

按照 VSS 降序排列输出内存快照:

procrank -v

默认procrank输出是通过PSS排序。

检索指定内容信息

查看指定进程的内存占用状态,命令格式如下:

```
procrank | grep [cmdline | PID]
```

其中 cmdline 表示需要查找的应用程序名,PID 表示需要查找的应用进程。 输出 systemUI进程的内存占用状态:

```
procrank | grep "com.android.systemui"
```

```
procrank | grep 3396
```

跟踪进程内存状态

通过跟踪内存的占用状态,进而分析进程中是否存在内存泄露场景。 使用编写脚本的方式,连续输出进程的内存快照,通过对比 USS 段,可以了解到此进程是否内存泄露。

示例:输出进程名为 com.android.systemui 的应用内存占用状态,查看是否有泄露:

1、编写脚本 test.sh

```
#!/bin/bash
while true;do
adb shell procrank | grep "com.android.systemui"
sleep 1
done
```

2、通过 adb 工具连接到设备后,运行此脚本:./test.sh

Dumpsys工具

Dumpsys 工具是 Android系统中自带的一款调试工具,运行在设备侧的 shell 环境下,提供系统中正在运行的服务状态信息功能。正在运行的服务是指 Android binder机制中的服务端进程。dumpsys 输出打印的条件:

- 1、只能打印已经加载到 ServiceManager中的服务;
- 2、如果服务端代码中的 dump 函数没有被实现,则没有信息输出。

使用Dumpsys

• 查看Dumpsys帮助

作用:输出dumpsys帮助信息。

```
dumpsys -help
```

• 查看Dumpsys包含服务列表

作用:输出dumpsys所有可打印服务信息,开发者可以关注需要调试服务的名称。

```
dumpsys -1
```

• 输出指定服务的信息

作用:输出指定的服务的 dump 信息。 格式:dumpsys [servicename]

示例:输出服务 SurfaceFlinger的信息,可执行命令:

dumpsys SurfaceFlinger

• 输出指定服务和应有进程的信息

作用:輸出指定服务指定应用进程信息。 格式:dumpsys [servicename] [应用名]

示例:输出服务名为 meminfo,进程名为 com.android.systemui 的内存信息,执行命

令:

注意: 服务名称是大小写敏感的, 并且必须输入完整服务名称。

Last log 开启

• 在dts文件里面添加下面两个节点

```
ramoops_mem: ramoops_mem {
    reg = <0x0 0x110000 0x0 0xf0000>;
    reg-names = "ramoops_mem";
};

ramoops {
    compatible = "ramoops";
    record-size = <0x0 0x20000>;
    console-size = <0x0 0x80000>;
    ftrace-size = <0x0 0x00000>;
    pmsg-size = <0x0 0x50000>;
    memory-region = <&ramoops_mem>;
};
```

```
- 在机器中查看last log
130|root@rk3399:/sys/fs/pstore # ls
dmesg-ramoops-0 上次内核panic后保存的log。
pmsg-ramoops-0 上次用户空间的log,android的log。
ftrace-ramoops-0 打印某个时间段内的function trace。
console-ramoops-0 last_log 上次启动的kernel log,但只保存了优先级比默认log level 高的 log。
```

• 使用方法:

```
cat dmesg-ramoops-0
cat console-ramoops-0
logcat -L (pmsg-ramoops-0) 通过logcat 取出来并解析pull out by logcat and parse cat ftrace-ramoops-0
```

FIQ模式

当设备死机或者卡住的时候可以在串口输入fiq命令查看系统的状态,具体命令如下:

sleep Allow sleep while in FIQ nosleep Disable sleep while in FIQ console Switch terminal to console

cpu Current CPU

cpu <number> Switch to CPU<number>

ps Process list
sysrq sysrq options

sysrq <param> Execute sysrq with <param>

log自动收集

• 收集的内容

android: android log
kernel : kernel log

- 打开方式
- 开启Developer options
- Setting-System-Advanced-Developer options-Android bug collector
- log保存路径

data/vendor/logs/

常见问题

当前kernel版本是4.4还是4.19?

develop-4.19,新的dts已经提交了,当前阶段需要打下面的2个补丁

如何获取当前SDK对应的RK release版本

Rockchip Android10.0 SDK包括aosp原始代码和RK修改的代码两部分,其中RK修改的仓库包含在.repo/manifests/include 目录下面的xml中,aosp默认的仓库在.repo/manifests/default.xml。

版本确认:

• RK修改部分

vim .repo/manifests/include/rk_checkout_from_aosp.xml
cproject groups="pdk" name="platform/build" path="build/make" remote="rk" revision="refs/tags/android-10.0-mid-rkr2">

说明RK的版本是android-10.0-mid-rkr2

• AOSP部分

```
vim .repo/manifests/default.xml
<default revision="refs/tags/android-10.0.0_r14"</pre>
```

说明OASP的版本是android-10.0.0_r14 当需要提供版本信息的时候提供以上两个版本信息即可。 单个仓库可以直接通过如下命令获取tag信息

```
/kernel$ git tag
android-10.0-mid-rkr1
android-10.0-mid-rkr2
develop-4.4-20190201
```

RK的版本是以android-10.0-mid-rkrxx的格式递增的,所以当前的最新tag是android-10.0-mid-rkr2

uboot和kernel阶段logo图片替换

uboot和kernel阶段的logo分别为开机显示的第一张和第二张logo图片,可以根据产品需求进行修改替换。

uboot logo源文件: kernel/logo.bmp

kernel logo源文件: kernel/logo_kernel.bmp

如果需要更换某一张只需用同名的bmp替换掉,重新编译内核即可,编译后的文件在boot.img中。说明:Logo图片大小目前只支持到8M以内大小的bmp格式图片,支持8、16、24、32位的bmp。

关机充电和低电预充

关机充电和低电预充可以在dts中配置,具体如下:

其中:

rockchip,uboot-charge-on: uboot关机充电,与android关机充电互斥rockchip,android-charge-on: android关机充电,与uboot关机充电互斥

rockchip,uboot-low-power-voltage: 配置低电预充到开机的电压,可以根据实际需求进行配置

rockchip,screen-on-voltage:配置低电预充到亮屏的电压,可以根据实际需求进行配置

Uboot阶段充电图片打包和替换

充电图片路径,可以直接替换同名文件,格式要求与原文件一样。

如果打开uboot充电,但是没有显示充电图片,可能是图片没有打包到resource.img中,可以按如下命令打包

```
cd u-boot
./scripts/pack_resource.sh ../kernel/resource.img
cp resource.img ../kernel/resource.img
```

执行以上命令后uboot充电图片会打包到kernel目录的resource.img中,此时需要再将resource.img打包到boot.img中,可以在android根目录执行./mkiamge.sh,然后烧写rockdev/下面的boot.img即可。

RK3328 BOX 干扰打印太多怎么办?

蓝牙打印:默认的 SDK 配置已经预置了一个属性,需要再打一下下面这个补丁,蓝牙就不再启动,就会少很多干扰打印,补丁位置:

Camera 打印: 需要将 rk3328_box/manifest.xml 中的 camera 接口进行注释,补丁位置: \\10.10.10.164\Q_Repository\RK3328\BOX\patch\device_rk3328_disable_camera.patch

RK3328 BOX联通板子U2口切换HOST/OTG模式的方法

```
echo host > /sys/devices/platform/ff450000.syscon/ff450000.syscon:usb2-
phy@100/otg_mode
echo otg > /sys/devices/platform/ff450000.syscon/ff450000.syscon:usb2-
phy@100/otg_mode
```

RM310 4G配置

4G功能SDK默认是关闭的,如需打开,按以下操作:

```
vim device/rockchip/common/BoardConfig.mk
#for rk 4g modem
-BOARD_HAS_RK_4G_MODEM ?= false
+BOARD_HAS_RK_4G_MODEM ?= true
```

A/B 系统配置

A/B系统就是设备上有A和B两套可以工作的系统,可以理解为一套系统分区,另外一套为备份分区。 A/B默认关闭,如需打开,在对应芯片的BoardConfig.mk中按如下配置打开(以RK3326为例):

```
vim device/rockchip/rk3326_qt/BoardConfig.mk
#AB image definition
-BOARD_USES_AB_IMAGE := false
+BOARD_USES_AB_IMAGE := true
```

Recovery旋转配置

支持Recovery旋转0/90/180/270度,默认不旋转(即旋转0度),旋转配置说明如下:

```
vim device/rockchip/common/BoardConfig.mk
#0: ROTATION_NONE 旋转0度
#90: ROTATION_RIGHT 旋转90度
#180: ROTATION_DOWN 旋转180度
#270: ROTATION_LEFT 旋转270度
# For Recovery Rotation
TARGET_RECOVERY_DEFAULT_ROTATION ?= ROTATION_NONE
```

SD卡启动功能

前提

- 机器没有EMMC或者NAND等存储设备,如果有则需要先擦除flash。
- SD卡功能需要打开,如果SD卡默认关闭的需要先在dts中配置打开,如RK3326。

代码修改

以RK3399为例

Android部分

```
device/rockchip/rk3399$
diff --git a/rk3399_Android10/rk3399_Android10.mk
b/rk3399_Android10/rk3399_Android10.mk
index d00e0a3..c031ecb 100755
--- a/rk3399_Android10/rk3399_Android10.mk
+++ b/rk3399_Android10/rk3399_Android10.mk
@@ -17,7 +17,7 @@
# First lunching is Q, api_level is 29
PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL := 29
PRODUCT_DTBO_TEMPLATE := $(LOCAL_PATH)/dt-overlay.in
-PRODUCT_BOOT_DEVICE := fe330000.sdhci
+PRODUCT_BOOT_DEVICE := fe330000.sdhci, fe320000.dwmmc
include device/rockchip/common/build/rockchip/DynamicPartitions.mk
include device/rockchip/common/BoardConfig.mk
$(call inherit-product, $(SRC_TARGET_DIR)/product/full_base.mk)
```

Kernel部分

dts的sdmmc节点加入supports-emmc字段,如下:

```
&sdmmc {
    clock-frequency = <150000000>;
    clock-freq-min-max = <100000 150000000>;
    supports-sd;
    bus-width = <4>;
    cap-mmc-highspeed;
    cap-sd-highspeed;
    disable-wp;
    supports-emmc;
    num-slots = <1>;
    sd-uhs-sdr104;
    vmmc-supply = <&vcc_sd>;
    vqmmc-supply = <&vccio_sd>;
    pinctrl-names = "default";
```

```
pinctrl-0 = <&sdmmc_clk &sdmmc_cd &sdmmc_bus4>;
    status = "okay";
};
```

制作工具

```
SDDiskTool_v1.59
```

替换 AOSP 部分源代码的 remote

客户下载RK的release代码时速度较慢,可以将AOSP的remote修改为国内镜像源,国外的客户可以修改为google的镜像源。这样可以提高下载速度。具体操作方法如下:

执行repo init(或者解压base包)后,修改.repo/manifests/remote.xml,把其中的 aosp 这个 remote 的 fetch 从

```
< remote name="aosp" fetch="./" review="https://10.10.10.29" />
```

改为

国内客户: (国内以清华大学镜像源为例,可以根据需要修改为其他国内镜像源)

```
< remote name="aosp" fetch="https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn"
review="https://10.10.10.29" />;
```

国外的客户: (google镜像源)

```
< remote name="aosp" fetch="https://android.googlesource.com"
review="https://10.10.10.29" />
```

GTVS更新方法

进到SDK工程vendor目录下, 执行

```
rsync -av --exclude '*.git' chenwei@10.10.165:/home/chenwei/google_gtvs .
```

由于目录不一致,因此需要调整一下gms.mk.sample中overlay的位置

```
# Add gms_tv specific overlay
-PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS += vendor/google/products/gms_tv_overlay
+PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS += vendor/google_gtvs/overlays/products/gms_tv_overlay

# Overlay for GMS devices
$(call inherit-product, device/sample/products/backup_overlay.mk)
$(call inherit-product, device/sample/products/location_overlay.mk)
-PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS += vendor/google/products/gms_overlay
+PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS += vendor/google_gtvs/overlays/products/gms_overlay

# Overrides
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
```

userdata区文件系统换为EXT4

默认data分区的文件系统为f2fs,建议不带电池的产品可以将data区的文件系统改为ext4,可以减小异常掉电后数据丢失的概率。修改方法如下:

以RK3399_Android10为例说明:

```
device/rockchip/common$ git diff
diff --git a/scripts/fstab_tools/fstab.in b/scripts/fstab_tools/fstab.in
index 266531a..52453ea 100755
--- a/scripts/fstab_tools/fstab.in
+++ b/scripts/fstab_tools/fstab.in
@@ -16,6 +16,6 @@ ${_block_prefix}product /product ext4 ro,barrier=1
${_flags},first_stage_mount
 # For sdmmc
 /devices/platform/${_sdmmc_device}/mmc_host*
                                                       auto auto
                                                                     defaults
   voldmanaged=sdcard1:auto,encryptable=userdata
 # Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime, nosuid, nodev, discard, reserve_root=32768, resgid=1065, fsync_mode=nobarrier
latemount, wait, check, fileencryption=software, quota, formattable, reservedsize=128M
,checkpoint=fs
+#/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime, nosuid, nodev, discard, reserve_root=32768, resgid=1065, fsync_mode=nobarrier
latemount, wait, check, fileencryption=software, quota, formattable, reservedsize=128M
,checkpoint=fs
# for ext4
-#/dev/block/by-name/userdata
                                  /data
                                             ext4
discard, noatime, nosuid, nodev, noauto_da_alloc, data=ordered, user_xattr, barrier=1
wait, formattable, check, fileencryption=software, quota, reservedsize=128M
+/dev/block/by-name/userdata
                                 /data
                                            ext4
discard, noatime, nosuid, nodev, noauto_da_alloc, data=ordered, user_xattr, barrier=1
wait, formattable, check, fileencryption=software, quota, reservedsize=128M
```

```
device/rockchip/rk3399$ git diff
--- a/device.mk
+++ b/device.mk
@@ -27,7 +27,7 @@ PRODUCT_PACKAGES += \
     libion
 #enable this for support f2fs with data partion
-BOARD_USERDATAIMAGE_FILE_SYSTEM_TYPE := f2fs
+BOARD_USERDATAIMAGE_FILE_SYSTEM_TYPE := ext4
 # used for fstab_generator, sdmmc controller address
 PRODUCT_SDMMC_DEVICE := fe320000.dwmmc
diff --git a/rk3399_Android10/recovery.fstab b/rk3399_Android10/recovery.fstab
index 7532217..cf789ac 100755
--- a/rk3399_Android10/recovery.fstab
+++ b/rk3399_Android10/recovery.fstab
@@ -7,7 +7,7 @@
/dev/block/by-name/odm
                                           /odm
                                                                ext4
defaults
                          defaults
 /dev/block/by-name/cache
                                           /cache
                                                                ext4
defaults
                          defaults
                                           /metadata
 /dev/block/by-name/metadata
                                                                ext4
defaults
                          defaults
```

-/dev/block/by-name/userdata		/data	f2fs
defaults	defaults		
+/dev/block/by-nam	e/userdata	/data	ext4
defaults	defaults		
/dev/block/by-nam	e/cust	/cust	ext4
defaults	defaults		
/dev/block/by-nam	e/custom	/custom	ext4
defaults	defaults		
/dev/block/by-nam	e/radical_update	/radical_update	ext4
defaults	defaults		

root功能

root功能的补丁:

RKDocs/android/patches/box/rootservice_for_android10.rar

修改开关机动画和开关机铃声

参考文档:

 $\label{lem:reduction_Android_Power_On_Off_Animation_and_Tone_Customization_CN\&EN.pdf$

APP设置性能模式

device/rockchip/rk3xxx/下配置文件:package_performance.xml,在其中的节点中加入需要使用性能模式的包名: (使用 aapt dump badging (file_path.apk)获取包名)

```
< app package="包名" mode="是否启用加速,启用为 1,关闭为 0"/>
```

例如针对安兔兔的参考如下:

```
< app package="com.antutu.ABenchMark"mode="1"/>
```

- < app package="com.antutu.benchmark.full"mode="1"\/>
- < app package="com.antutu.benchmark.full"mode="1"\/>

编译时会将文件打包进固件。

从Android 9.0 OTA升级到Android 10.0

Android10.0 SDK 支持从Android 9.0版本通过OTA的方式升级到Android10.0,具体可以参考文档:

 $\label{lem:reduction_OTA_from_Android9.0_to_Android10.0_CN\&EN.pd for the control of the contro$

GPU相关问题排查方法

参考下面文档,可以做初步的问题排查

OTP和efuse说明

OTP支持芯片

- RK3326
- PX30 EFUSE支持芯片
- RK3288
- RK3368
- RK3399固件签名和otp/efuse烧写参考文档

RKDocs\common\security\Rockchip-Secure-Boot-Application-Note-V1.9.pdf

分区修改

修改分区大小

分区大小在parameter文件中定义,具体位置在产品的目录下,如rk3326_qgo产品的parameter文件在如下路径:

device/rockchip/rk3326/rk3326_qgo/parameter.txt

parameter文件的介绍请参考文档

RKDocs/common/RKTools manuals/Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4-CN.pdf

增加分区

新加分区的步骤:

- parameter文件中加入分区大小和地址信息,参考上面的说明;
- fstab中加入分区挂在信息, fstab文件默认路径 (有些产品在产品目录下):

device/rockchip/common/scripts/fstab_tools/fstab.in

• recovery.fstab中增加分区信息, recovery.fstab文件路径在具体的产品目录下, 如rk3326_qgo:

device/rockchip/rk3326/rk3326_qgo/recovery.fstab